

公司代码：688368

公司简称：晶丰明源



上海晶丰明源半导体股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），预计派发现金红利人民币61,600,000元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的89.45%。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。上述2020年度利润分配中现金分红金额暂按公司2020年年度报告披露日公司总股本61,600,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。

本事项已获公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	晶丰明源	688368	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	汪星辰	张漪萌
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
电话	021-51870166	021-51870166
电子信箱	bpsemi@bpsemi.com	bpsemi@bpsemi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、 主要业务

晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，主营业务为模拟半导体电源管理类芯片的设计、研发与销售。自2008年成立以来，公司即专注于LED照明驱动芯片领域，经过十余年的创新与发展，公司积累了大量客户资源，为昕诺飞、Savant Company、朗德万斯、佛山照明、三雄极光、欧普照明、雷士照明、Yeelight、宁波凯耀、立达信、得邦照明、阳光照明等众多国际、国内知名企业提供产品。

2、 主要产品情况

电子设备系统中，电源管理芯片承担着电能的变换、分配、检测及其他电能管理等多种职能，应用场景广泛。不同电子系统对电源要求不同，因此选择合适的电源管理芯片至关重要。

公司现有产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等，其中LED照明驱动芯片包括通用LED照明驱动芯片、智能LED照明驱动芯片；AC/DC电源管理芯片包括内置AC/DC电源芯片及外置AC/DC电源芯片。

通用LED照明驱动芯片是指应用于日常LED照明产品的恒流驱动芯片。

智能LED照明驱动芯片是指在通用产品的基础上增加了信息接口或模组，模组电源芯片以及带调光或者调色接口的恒流驱动芯片，主要应用于照明的多元智能化场景。

电机驱动芯片是指集成了电机的控制速度、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路，主要应用于家用电器、电动工具、工业伺服等领域，是电机驱动系统的电源管理驱动芯片。

内置AC/DC电源芯片作为电压转换器的驱动控制芯片，将220V交流市电转换为目标所需的低压直流电，向大、小家电内的微控制器MCU或其它用电单元提供精确稳定的电能，使其能够在各种外界环境中保持长时间正常工作。

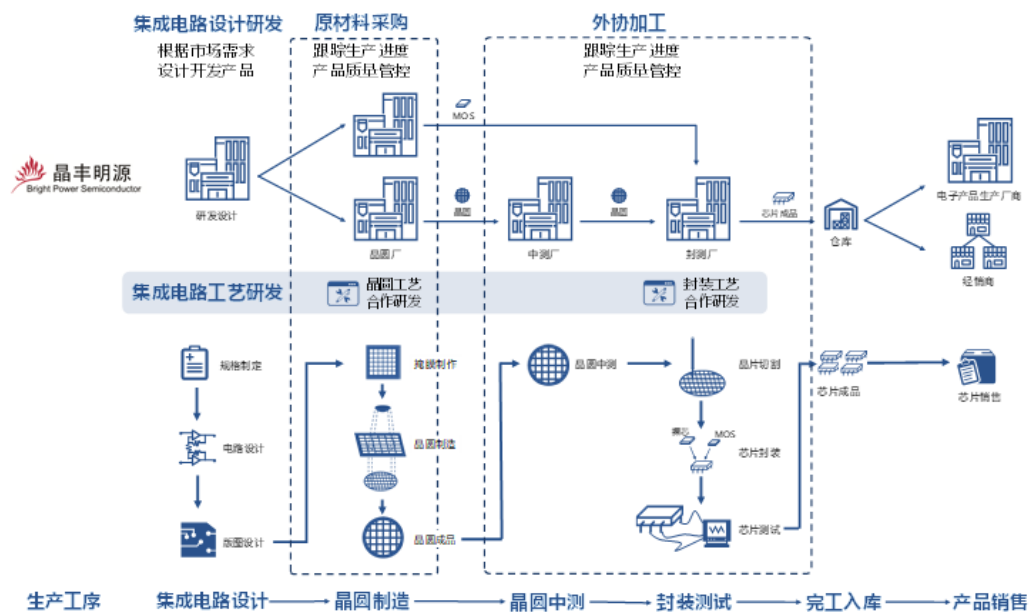
外置AC/DC电源芯片，是给适配器供电及手机充电的电源模组的核心控制器件，负责将交流电高效的转化为所需的直流电源。其适用的终端设备包括：手机快充、机顶盒、路由器、视频监

控以及如扫地机器人、剃须刀等家庭护理工具等。

(二) 主要经营模式

公司在传统 Fabless 集成电路设计企业基础上，增加自研芯片制造工艺和封装制造工艺，比大多数典型使用晶圆厂和封装厂标准工艺的 Fabless 集成电路设计企业具有更好的灵活性和适应性，有利于晶圆产能扩展和产品差异化。在此模式下，公司专注于集成电路的研发、设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆制造、芯片封装及测试厂商。Fabless 模式有助于公司保持轻资产模式，不断增强业务灵活性。

Fabless 模式下，公司产品主要生产工序及实物流转情况如下图：



1. 研发模式

公司的产品开发以客户需求为基础，基于业务部门对国内外市场动态及客户需求进行调研而形成的调研意见，研发部及产品部制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作，满足多样化的客户需求；公司也通过产学研、企业间合作等多种技术合作研发模式，加强对外技术开发交流以及对行业前沿技术进行储备。

2. 采购模式

Fabless 模式下，公司采购的主要产品为定制化晶圆，即公司将自主研发设计的集成电路版图交付晶圆制造商进行晶圆生产，经过产品试产后根据市场需求向晶圆厂下达采购订单。

3. 生产模式

公司生产模式以外协加工为主，产品主要的生产环节包括晶圆中测、封装、测试等均通过委托第三方加工的方式完成。在封装和测试阶段，封装和测试厂商完成芯片封装和测试，并将经过

封装并测试合格的芯片产品入库或发往指定的交货地点。

4. 销售模式

公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，主要通过经销商销售产品。在经销模式下，公司向经销商进行买断式的销售；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

（三） 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

伴随现代信息技术产业的快速发展，集成电路产业作为其基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性新兴产业；在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用；是当前国际竞争的焦点；是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一；也是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的重要产业之一。

根据 IC Insights 报告显示，中国自 2005 年成为全球最大 IC 市场后，规模保持持续增长。截至 2020 年，中国集成电路市场规模增至 1,434 亿美元，较 2019 年的 1,313 亿美元增长 9%。在国家产业政策和行业密集投资的双重驱动下，我国集成电路产业技术水平快速提升，技术创新步伐不断加快，预计未来仍将保持增长态势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在 LED 照明行业发展的各个阶段均率先掌握了多项核心技术。领先的技术及研发实力保证了公司在 LED 照明驱动芯片领域较高的市场地位。近年来，通过与客户长期深入的合作，公司积累了稳定的客户资源。

基于通用 LED 照明产品积累的技术背景及行业资源，公司在 LED 照明市场出现智能化需求时，率先对智能 LED 照明驱动产品进行了研发与市场布局。目前，该市场仍处于早期阶段，公司利用先发优势，运用已经掌握的领先技术，推出一系列具有调光、调色、远控、互动智能需求的产品。同时，在照明产品智能化发展过程中，照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术跨界融合，派生出 LED 照明行业的新兴需求。在智能 LED 照明驱动芯片设计领域，公司目前处于行业领先地位。

在公司新布局的内置 AC/DC 电源芯片大家电应用领域及外置 AC/DC 电源芯片应用的快充领域，主要市场长期被国外竞争对手占据，国产厂商仍处于初步进入市场阶段。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司在生产工艺方面完成了第五代 BCD-700V 工艺平台的研发工作，该平台的应用将使产品成本进一步降低，同时优化了晶圆产能的有效利用。

随着国际局势的不断变化以及我国芯片设计企业的不断发展，技术“自主可控”已经成为国内企业产业转型升级的基础。公司基于原有 LED 照明市场的技术积累，开发出应用于大、小家电的内置 AC/DC 电源芯片以及应用于充电器、适配器的外置 AC/DC 电源芯片产品。恰逢行业下游客户正处于选择各个关键配件进行国产替代的黄金时期，公司将不断向客户提供更具成本优势、性能进一步优化的产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,627,590,561.92	1,372,366,742.90	18.60	392,011,684.45
营业收入	1,102,942,313.83	873,676,944.81	26.24	766,591,245.41
归属于上市公司股东的净利润	68,863,250.12	92,343,910.72	-25.43	81,331,140.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,631,579.97	79,259,406.56	-65.14	74,449,494.58
归属于上市公司股东的净资产	1,258,967,839.77	1,132,706,189.29	11.15	252,566,108.13
经营活动产生的现金流量净额	-4,954,634.16	68,647,607.49	-107.22	37,009,929.09
基本每股收益（元/股）	1.12	1.89	-40.74	1.76
稀释每股收益（元/股）	1.11	1.89	-41.27	1.76
加权平均净资产收益率（%）	5.76	21.47	减少15.71个百分点	34.52
研发投入占营业收入的比例（%）	14.29	7.75	增加6.54个百分点	7.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	181,731,240.39	202,671,583.13	322,365,934.76	396,173,555.55
归属于上市公司股东的净利润	2,739,982.40	6,697,154.00	20,450,343.97	38,975,769.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,525,204.05	-195,653.11	8,972,604.82	22,379,832.31
经营活动产生的现金流量净额	-45,034,404.13	7,475,247.02	-8,446,221.88	41,050,744.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		2,338						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		1,656						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持 股数 量	比 例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	包含转融 通借出 股份的 限售股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
胡黎强	0	16,564,500	26.89	16,564,500	16,564,500	无	0	境内 自然 人
夏风	0	15,115,500	24.54	15,115,500	15,115,500	无	0	境内 自然 人
上海晶哲瑞企 业管理中心 (有限合伙)	0	13,320,000	21.62	13,320,000	13,320,000	无	0	境内 非国 有法 人

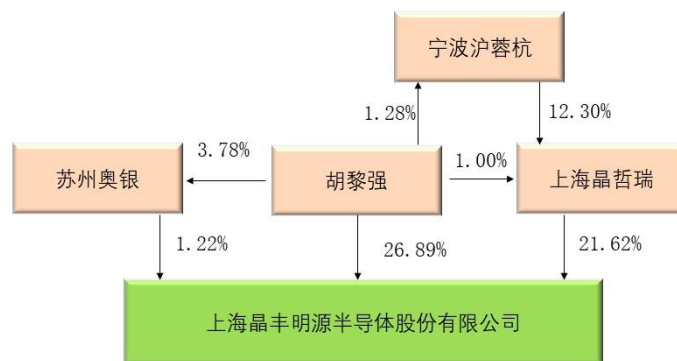
苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	0	750,000	1.22	750,000	750,000	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	595,000	595,000	0.97	0	0	无	0	其他
广发乾和投资有限公司	-53,900	556,716	0.90	556,716	705,716	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	509,231	509,231	0.83	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	492,141	506,141	0.82	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	0	497,914	0.81	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	471,830	471,830	0.77	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）1%的股份，并为上海晶哲瑞执行事务合伙人，对上海晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份。夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

适用 不适用

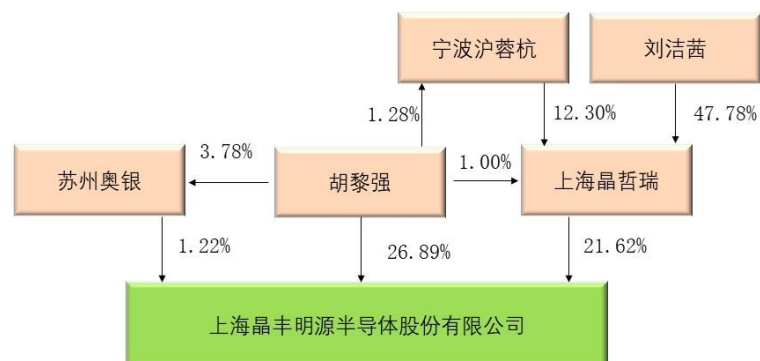
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

具体参见本章“一、经济情况讨论与分析”的相关内容。

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并财务报告范围内子公司如下：

子公司名称
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited
上海芯飞半导体技术有限公司
上海莱狮半导体科技有限公司

董事长：胡黎强
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2021 年 4 月 15 日